

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 8 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长石明达先生、董事副总经理夏鑫先生、独立董事袁学礼先生、副总经理兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监朱红超先生、保荐代表人程韬先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复:</p> <p>问题一：22 年公司制定的经营目标如何？收入和利润分别要增长多少？</p> <p>答：公司 2022 年业务发展趋势向好，计划 2022 年实现营业收入 200 亿元，较 2021 年实绩增长 26.49%，预计经济效益也将同步实现增长。谢谢！</p> <p>问题二：现阶段疫情对公司产能是否有影响？</p> <p>答：谢谢您的关注！公司目前生产经营正常，克服困难，封闭运营，维持一线生产。疫情对公司物流有一定影响。</p> <p>问题三：董秘好，能不能介绍一下公司的经营情况？</p> <p>答：公司主要从事集成电路封装测试一体化服务。2021 年，是公司发展历程中浓墨重彩的一年，公司实现营业收</p>

入 158.12 亿元，同比增长 46.84%，在 2020 年百亿营收的基础上，继续实现大幅增长，公司市占率较 2020 年持续提升，营收规模继续排名全球行业第五位；公司盈利显著提升，2021 年实现净利润 9.66 亿元，同比增长 148.76%，创历史最高水平。

2021 年，公司技术研发水平再创新高，公司作为主要参与完成单位、石磊总经理作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖；公司承担的国家重大科技“02 专项”顺利收官；在先进封装方面公司已大规模生产 Chiplet 产品，7nm 产品已大规模量产，5nm 产品已完成研发即将量产，公司技术实力上升到一个前所未有的高度。

在高性能计算方面，公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，目前已建成国内高端处理器产品最大量产封测基地；在存储器方面，公司与长江存储、长鑫存储结为战略合作伙伴，已大规模生产存储产品；在汽车电子、功率 IC 方面，公司布局多年，拥有丰富的客户资源和深厚的技术积累，具备强大的竞争优势；在 MCU 方面，公司与海外及国内知名 MCU 芯片公司长期稳定合作，业务规模持续高速增长；在显示驱动芯片方面，公司率先布局，已导入国内外第一梯队客户，业务即将进入爆发期；在 5G 方面，公司持续以“先进封装耕耘 SOC 大客户，提高周边配套芯片客户份额”为策略，相关业务将持续增长。

公司 2022 年业务发展趋势向好，计划 2022 年实现营业收入 200 亿元，较 2021 年实绩增长 26.49%，预计经济效益也将同步实现增长。

问题四：半导体具有周期性，目前处于什么阶段？

答：根据 IC Insights 今年一月份半导体行业预测，预计 2022 年的半导体总销售额将再增长 11%。全球半导体行业景气度向好，下游应用领域不断延展，随着芯片越来越多

地应用到现在和未来的关键技术中,预计未来几年对半导体产品的需求将显著增加。

问题五: 公司市占率多少?

答: 2021年, 公司市占率较2020年持续提升, 营收规模继续排名全球行业第五位。

问题六: 公司2021年营收增幅达47%, 营收增长的原因, 公司产品有什么竞争优势?

答: 2021年度, 受全球智能化加速发展、电子产品需求增长等因素影响, 公司国际和国内市场需求呈现旺盛态势, 公司在全球半导体供应链产能紧张的情况下, 通过科学管理和有效组织, 实现产能最大化, 提升资源配置效率, 全力聚焦, 满足重点战略客户的订单交付需求。

2021年, 公司继续加强与国内外各细分领域头部客户的深度合作, 保稳业务压舱石, 并强化与客户不同产品线全面合作。在高性能计算方面, 公司继续保持AMD高端处理器封测优势的同时, 进一步开拓国内外其他客户; 公司深耕车载市场20年, 在汽车电子国产化趋势下, 大规模导入国产车载产品, 成为国产头部汽车芯片客户首选封测合作伙伴; 在功率IC方面, 公司充分发挥功率模块产品领先优势, 围绕“碳达峰、碳中和”相关政策, 重点发展超高压电网、新能源汽车领域的功率产品, 并积极与客户开展在碳化硅(SiC)/氮化镓(GaN)以及Si IGBT模组的深化合作; 在无线网络方面, 基于高密度DRQFN封装技术, 公司持续为联发科、NXP客户在WIFI6 SoC产品上提供有力支持。

公司实现营业收入158.12亿元, 同比增长46.84%, 实现净利润9.66亿元, 同比增长148.76%, 创历史最高水平。

问题七：公司未来的盈利增长点？

答：公司不断深化客户合作，优质客户持续扩容带来经营规模快速增长。公司与 AMD 形成“合资+合作”的模式，2021 年约 44.5%的收入来自于 AMD，随着台积电持续加大先进制程扩产力度，AMD 所面临的产能紧缺问题有望缓解，从而带动公司的封测需求提升。此外，公司持续加强与联发科、长鑫存储、长江存储等头部客户的深度合作，大力布局高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，未来优质客户扩容有望带动公司经营规模持续向上。

问题八：公司主要原材料基板的采购，是否会因为供应商产能紧缺成为公司产能扩张的瓶颈？

答：公司高端基板主要从日本采购，一般我们会找至少找 3 家以上材料供应商，以 1 家为主，另外几家为辅，其中一家是国内厂家，确保供应链的稳定及安全。

问题九：公司与客户有啥合作？

答：公司与国内优质存储客户深度合作，共同研发高性能 2.5D&3D 封装技术；公司与国内龙头企业在合作研发，应用于 AI/HPC/X-PU/ADAS 等领域的 FCBGA 封装技术。

问题十：2021 年境内客户比例明显提升原因？

答：2020 年，我国半导体自给率仅为 15.9%，距离国家制定“2025 年芯片自给率达到 70%”的目标还有很大空间，随着国产化的进程的不断加快，也必将推动封测需求的进一步增长。在“缺芯”状况下，海外产业链上的企业容易“选边站”，更加加大了国内封测企业的机会。

2021 年，在高性能计算方面，公司积极开拓国内其他大客户；在汽车电子方面，公司大规模导入国产车载产品，成为国产头部汽车芯片客户首选封测合作伙伴；公司与绝

大多数国内知名集成电路设计公司的合作，进一步深化，业务规模不断提升。

综上，公司紧抓半导体国产化带来的发展机遇，巩固与国内行业头部客户以及战略伙伴的合作关系；甄选潜力客户，提前布局国内市场，并取得了优良的业绩。2021年，公司实现中国境内收入 50.21 亿元，同比增长 122.57%；而同期境外收入同比增长 26.77%。由此可见，半导体国产化给公司带来了巨大的发展空间。

问题十一：公司国外营收占比大于 60%，国外营收未来是否持续稳定，在目前外部环境日渐不确定的情况下，未来如何平衡国内外营收比例，谢谢！

答：公司国外营收，主要来自 AMD、以及其他欧美、日韩等国家、台湾地区的客户。公司与 AMD 续签了制造服务协议，有效期到 2026 年，其外包业务的 80%给到公司下属子公司。目前，AMD 发展态势很好，这部分业务有保障。其他海外市场，公司经过 20 多年耕耘，与客户已建立了密切的合作关系，成为 MTK 在大陆地区重要的合作伙伴，这部分业务也不会受到影响。

公司将继续加强与国内外各细分领域头部客户的深度合作，保稳业务压舱石，并强化与客户不同产品线全面合作。谢谢。

问题十二：公司是做封测，目前公司有没有技术壁垒？

答：2021 年，公司技术研发水平再创新高，公司作为主要参与完成单位、石磊总经理作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖；公司承担的国家重大科技“02 专项”顺利收官；在先进封装方面公司已大规模生产 Chiplet 产品，7nm 产品已大规模量产，5nm 产品已完成研发即将量产，公司技术实力进一步提升。谢谢！

问题十三：公司涉及华为叠加芯片封装技术吗？与华为是否有合作？

答：大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，公司全力支持国内客户的发展。由于公司与客户签署了保密协议，具体客户名字不便披露。谢谢！

问题十四：贵公司 3D 封测产品，听说可以提升不少性能，但看来看去，很多人都觉得封测没有技术含量，相比含金量也很低，贵公司怎么看？

答：随着摩尔定律接近极限，芯片工艺的提升也受到限制，通过先进封装技术来提升产品性能，就显得越来越重要。晶圆制造商台积电也进入了 2.5D、3D 封装领域，说明仅依靠晶圆制程，也会受到限制，凸显了先进封装技术的重要性。

公司在 2.5D、3D 先进封装领域在国内处于领先地位，建立了完整的生产线，与世界一流公司在存储、GPU、CPU 等领域开展合作。从研发阶段，就与客户开展密切合作，进一步推动公司产品技术进步，拓展了公司业务份额。

问题十五：公司技术目前是自研还是外延式并购获取？

答：自研和外延并购都有。公司产品线非常广泛，注重技术研发，前期的研发带来了后期的快速增长。技术研发方面，以“02”专项为抓手，设立了技术研究院，引进了高端技术人才；公司与日月光、矽品、安靠在技术上，没有代差；技术研发与客户需求紧密绑定。

问题十六：蒋总，封测砍单的传闻有些日子了，想请问公司目前的订单和产能利用率怎么样？

答：您好！公司生产经营情况正常，目前总体产能利用率在 80%至 90%之间。谢谢！

问题十七：后续的产能扩张计划？

答：围绕“营收三年翻一番”的目标，根据市场需求，保持适度的产能扩张。

问题十八：公司持续大额投资紧追国产化浪潮，是否过于冒进？你怎么看？

答：感谢您的关注！公司不忘初心，产业报国，希望在实干兴邦的道路上砥砺前行，取得突破。没有哪一项投资没有风险，但要增强企业实力，短时间内实现弯道超车，就得有阔步向前的勇气和决心。当然，实际投资时，我们也会做好各项分析，审慎决策。

问题十九：扩产这么多实际产出时候会有过剩风险吗？

答：公司经过 20 多年耕耘，已成为封测行业产品、技术最全面的公司，可为客户提供全面的一体化服务，让客户省心、安心。

公司通过提前布局，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，在国内处于优势地位。2020 年，我国半导体自给率仅为 15.9%，距离国家制定“2025 年芯片自给率达到 70%”的目标还有很大空间，随着国产化的进程的不断加快，也必将推动封测需求的进一步增长。在“缺芯”状况下，海外产业链上的企业容易“选边站”，更加加大了国内封测企业的机会。

虽然市场存在波动，还是能看到中国集成电路高速增长的趋势。

公司将根据市场形势，结合自身的实际状况，审慎制定扩产进度计划，尽量避免产能闲置。

问题二十：公司各厂的产能利用率，新产线建设的爬坡计划？

答：存储器、Fanout、SiP、显示驱动芯片等新产线 22 年均在增量。

问题二十一：和长电科技华天科技相比，公司的净资产收益率最低，公司如何提高净资产收益率，和其他厂家相比有优势？

答：1、公司新项目投入、产出、收益有个过程，公司净资产收益率从 2020 年 4.96%增长到 2021 年的 9.51%，增长 4.55%，实现了大幅增长，进入收获期，未来净资产收益率会提高。

2、公司与华天、长电比较优势

公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，此外积极布局 Chiplet、2.5D/3D 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

3、公司通过内部运营的效率提升，产能利用率的提升，缩短交货期，减少存货，加快资产与资金的周转，同时通过不断调整供应商的策略，降低采购成本，提升公司整体盈利能力，提高净资产收益率水平。

问题二十二：您介绍一下员工激励的持股情况么？

答：为了公司可持续发展，建立劳动者与所有者的长效利益共享机制，经公司七届十一次董事会、七届九次监事会、2022 年第一次临时股东大会审议批准，通富微电准备实施股票期权激励计划。本激励计划拟向不超过 870 名激励对象授予 1,120 万份股票期权，授予的股票期权行权价格为 17.85 元/份。具体内容，详见公司 3 月 14 日披露的相关公告。谢谢！

问题二十三：董事长您好！请问去年授予的员工激励股票，今年6月有部分解锁流通么？

答：我们将根据第一期员工持股计划中考核指标的完成情况，来确定是否解锁。谢谢！

问题二十四：半导体人才紧缺，公司如何留住人才？

答：人才的需求和培养对一个快速发展的公司来说永远是个挑战，公司已推出员工持股计划、股权激励等措施，通过引进和自己培养的人才基本满足公司当下发展的需求。谢谢。

问题二十五：我想问下达总，像你们厦门厂自动化程度这么高，你们招应届生是怎么培养的？

答：公司为新入职员工提供了安全、质量、环境及职业素养等基础课程的培训，旨在帮助新员工了解公司业务流程和相关规章制度，以尽快适应公司的管理模式；同时安排相关优秀技术管理人员、优秀员工和岗位能手作为帮带师傅，对新员工进行一对一传帮带的岗前技能培训，以使新员工尽快胜任本职工作。

问题二十六：一季报预告没有吗？第一季度利润如何？

答：根据深交所规定，如公司预测：1、净利润为负值；2、净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；3、与上年同期相比实现扭亏为盈的，公司将按照深交所规定履行信息披露义务。2022年一季度业绩情况，敬请关注公司后续披露的一季报内容。谢谢！

问题二十七：公司先进封装和传统封装的比例是多少？

答：公司先进封装已大规模产业化，先进封装收入占比超过70%。谢谢！

问题二十八：本次定增发行价格定价基准日确定了么？

答：你好！本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。目前，发行期首日暂未确定。

问题二十九：什么时候完成定增？

答：非公开发行批文有效期 12 个月，我们会根据公司及二级市场情况，择机发行。感谢您的关注！

问题三十：年年搞定向增发，是对长期投资者的一种伤害，为什么不搞可转债之类的，希望不要再搞定向增发了。

答：受益于集成电路国产化、智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G 等新技术新需求的落地应用，半导体行业仍处于高景气周期。在全球半导体产业链向中国大陆迁移的大背景下，伴随着国内终端厂商逐渐将供应链向国内转移的趋势，国内封装测试企业面临良好的发展机会。在上述背景下，基于对行业及公司发展前景的信心，我们拟通过非公开发行募集资金，用于募投项目的建设，根据市场需求扩充产能，进一步提升公司在集成电路封测领域的生产能力和综合竞争力。正是因为不断的投入和布局，公司的营收才能持续扩大，也才有更好的基础，去实现 2022 年营收 200 亿元的目标。

当然，我们今后也会探讨可转债之类的其他再融资方式，感谢您的建议！”

问题三十一：请问本次定增，国家大基金有无意愿？

答：感谢您的关注！目前，暂无相关信息。

问题三十二：作为股民原来很看重通富微电，股票跌成这个样子，公司高管有什么举措吗？

答：2022 年以来，半导体板块上市公司的股价均出现了较大幅度的调整。二级市场股价不仅仅取决于公司基本

面，还受到宏观经济环境、政治关系、大盘走势、行业景气度、市场情绪、投资者心理等诸多因素影响，具有波动性。公司将不断提升经营管理能力与核心竞争力，努力提升营收规模，以良好的业绩提升公司价值，我们坚信长期价值投资的理念，“是金子总会发光的”！

问题三十三：半导体行业发展的很好，股价缺没表现，老板怎么看。

答：半导体行业的大环境是好的，公司始终夯实基本功，及时关注市场，认真服务好每个客户，是我司的根本。公司的股价除与公司业绩挂钩外，还与市场情绪有关，随着公司业务的持续发展，公司一定会给投资者好的回报。

问题三十四：公司的闲钱用于理财，为什么不用于维持股价？

答：1、公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。这只是公司的计划，最终以公司资金实际情况来决定。2、公司通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，增厚公司的利润，实质上也在维护公司的股价，为公司股东谋取更多的投资回报。

问题三十五：请问有无回购计划？

答：我们会积极研究相关监管政策和要求，后续如有股份回购相关计划，公司将依照相关规定及时履行信息披露义务，再次感谢您对公司的关注，谢谢！

问题三十六：请问有考虑做市值管理吗？

答：公司股价不仅仅取决于营收规模，还受到宏观经济、

市场情绪、资金面是否紧张等诸多因素的影响。公司一直重视市值管理，一方面，公司管理层将继续围绕发展战略及经营目标、尽职尽责经营好公司，并致力于以稳健的业绩、持续的发展带动公司市值的动态提升；另一方面，公司通过互动易平台、网上业绩说明会、公众邮箱、投资者热线电话、现场调研、策略会等各种方式保持与国内外投资者的积极沟通，有效传递公司价值与积极变化，吸引了更多投资者关注公司。我们将持续做好市值管理工作，来更好的回报二级市场投资者。谢谢！

问题三十七：公司打算什么时间完成千亿市值目标？

答：受益于集成电路国产化、智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G 等新技术新需求的落地应用，半导体行业仍处于高景气周期。国家支持集成电路产业发展的政策红利会继续得到释放，在强劲有力的国产化需求以及全球新技术革新的推动下，国内封测企业即将迎来更为有利的发展局面。公司将不断提升经营管理能力与核心竞争力，努力提升营收规模，以良好的业绩提升公司市值！谢谢！

问题三十八：股价一直下跌，公司为何不分红，投资者投资的意义何在？

答：根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司拟在本次非公开发行完成后，在 2022 年中期讨论分配事宜，原则上以不低于 2021 年度实现的母公司可分配利润的 10% 予以现金分红。综上，公司

不是不分红,我们将在非公开发行完成后,择机实施分红。公司将不断提升经营管理能力与核心竞争力,努力提升营收规模,以良好的业绩提升公司价值,回报投资者!”。

问题三十九:中期分红,参与定增的机构有份么?

答:公司如中期分红,将根据相关法律法规的要求,确定分红对象。谢谢!

问题四十:公司低毛利率,低净利润,高负债率,都比同业的要差,常看到贵公司说业绩如何满产怎样,但数据可见收益很一般,请问你们如何改善提升?能客观说明一下吗?谢谢!

答:提升内功,增加自身产品的市场竞争力,继续加强与头部客户的深度合作,积极在新兴应用领域中培育发展有潜力的新客户,优化产品结构,提升公司毛利率。

通过公司内部运营的效率提升,产能利用率的提升,缩短交货期,减少存货,加快资产与资金的周转,提升公司毛利率。通过不断调整供应商的策略,降低采购成本,募集资金到位后,降低财务费用。

问题四十一:公司各厂的折旧情况?通富超威苏州厂、通富超威槟城厂是否已经全部计提完折旧?

答:通富超威苏州厂、通富超威槟城厂的机器设备折旧年限是2-5年,其他工厂为8年。过去三年(2019-2021),通富超威苏州厂、通富超威槟城厂计提折旧共计21.52亿元,占公司折旧总额的45.94%。通富超威苏州厂、通富超威槟城厂生产经营规模不断扩大,营收大幅增长,每年持续新增固定资产投资,每年有新增固定资产计提的折旧。所以,目前不存在全部计提完折旧的情况。

问题四十二:最近有机构对贵司进行调研吗?

	<p>答：机构调研情况，详见公司披露的投资者关系活动记录表。谢谢！</p> <p>（公司 2021 年度业绩网上说明会全部内容可在全景网（http://ir.p5w.net）进行查阅。）</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 8 日